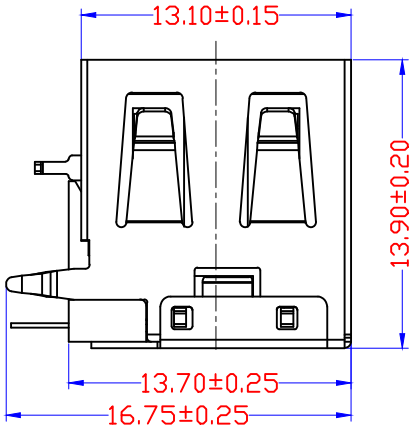

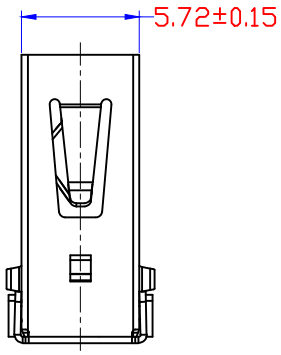

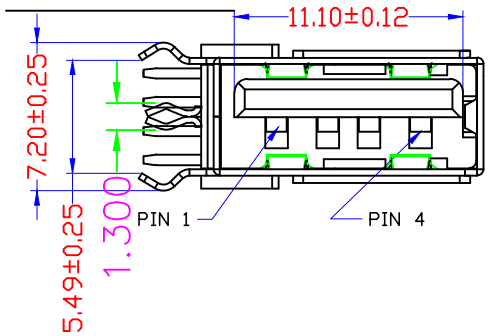

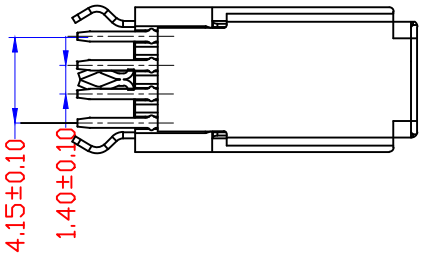

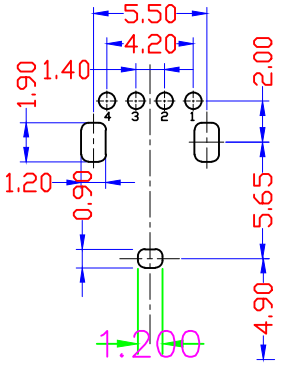

RECOMMEND PCB LAYOUT

1. Material:
   Contaeis:Phosphone Bronze
   insulater:PBT+30%
   G.F.UL 94V-0
   Shell:SPCC
2. Mechanical:
   Mating:35N max.
   Withdrowa Force:10N min.
   Darabirity:1500 cycles min.
3. Elecetical:
   Current-max(amps)1.5A
   Voitage-max(volls)30V
   Withstanding Voltage 750V AC
   Contact Resistance(ohms)30 milliohms max insulation Resistance(ohms)1000 Megogms min.
4. Plating:
   Contacts:Gold And Tin Over Nickel Ploled
   Shell: Nickel over all plating.
5. Environmental:
   Iemperature Range:-55 to 85 .

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: USB AF 短体侧插无卷边0型脚	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC04-USBA04-140
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.	
	APPROVED BY: 邱国夷	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-USB15101516
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO.	1 OF 1

深圳市华宇创精密电子有限公司

产品规格书

名称：USB AF 系列		版次：A.0
料号：	日期:09-02-06	页次：1/1

1、尺寸和外观：	
1～1	产品结构和尺寸要求与提供的图纸相符。
1～2	外观无氧化、赃污、变形、发白、白班、生锈等。
2、材料和表面处理	
2～1	端子材料：磷铜
2～2	端子电镀：(Ni)60ц″ ,焊接部位镀锡(Sn)100ц″
2～3	外壳材料:黄铜
2～4	外壳电镀:底层镀铜(Cu)80ц″-100ц″,表层镀镍(Ni)80ц″-100ц″
2～5	绝缘材料:UL94V-0级,热塑性加玻璃纤维LCP
3、电气性能	
3～1	接触电阻:≤30毫欧
3～2	绝缘电阻:≥1000兆欧
3～3	耐压:500V AC 一分钟
3～4	工作环境:-55℃ -105℃
4、成品对插保持力	
4～1	拔出力:1.0Kg以上
实测	2.55 2.50 2.45 2.65 2.35 2.83 2.52 2.44 2.80 2.75

深圳市华宇创精密电子有限公司

材料质量证明书

品名：USB AF 系列外壳	版次：A.0
材料规格：双光铁	页次：1/1
合金编号：C2680R-1/2H	日期：09-02-06

厂商：广州东时创展贸易有限公司

1、化学成分分析：

实验 方法：光普分析法

化学成分							
		Cu	Pb	Fe	Bi	P	Sn
标准	Min	63.5	/	/	/	0.1	/
Spec	Max	66.5	0.02	0.01	0.002	0.01	/
实测	Actear	65.4	0.008	0.025	/	0.16	余量

2、机械性能

项目		抗拉强度（kgf/mm2)	延伸率（%）	硬度（HV）
标准	Min	/	23	160
Spec	Max	/	/	180
实测值		471	23	170

3、尺寸公差

名称	厚度	宽度	长度
标准	0.30±0.01	300±0.5	/
Min	0.39	304.5	/
Max	0.41	305..5	/

深圳市华宇创精密电子有限公司

电镀报告表

品名：USB AF系列 （含铜/铁）		版次：A.0
电镀规格：Cu80ц″-120ц″-Ni80ц″-100ц″	日期：09-02-06	页次：1/1

厂商：恒鑫源五金电镀厂

测试设备：CMI X-射线膜厚测试仪

1、底层电镀测试（!Ni）

数据（No）	Ni	测试日期	测试时间
1	89.2ц″	2009-2-6	20:18:16
2	87.5ц″	2009-2-6	20:18:16
3	94.3ц″	2009-2-6	20:18:16
4	99.8ц″	2009-2-6	20:18:16
5	98.4ц″	2009-2-6	20:18:16

2、表层电镀测试（Cu）

数据（No）	Ni	测试日期	测试时间
1	96.5ц″	2009-2-6	20:18:16
2	94.7ц″	2009-2-6	20:18:16
3	88.4ц″	2009-2-6	20:18:16
4	107.2ц″	2009-2-6	20:18:16
5	110.2ц″	2009-2-6	20:18:16

深圳市华宇创精密电子有限公司

材料质量证明书

品名：USB AF 系列 端子	版次：A.0
试材规格：黄铜　T=0.25	页次：1/1
合金编号：C5191R-H	日期：09-02-06

厂商：北京金鹰铜业有限公司

1、化学成分分析：

实验 方法：光普分析法

化学成分							
		Cu	Pb	Fe	Bi	P	Sn
标准	Min	/	/	/	/	0.1	6
Spec	Max	/	0.02	0.05	0.002	0.25	7
实测	Actear	余量	0.007	0.008	/	0.16	6.85

2、机械性能

项目		抗拉强度（kgf/mm2）	延伸率（%）	硬度（HV）
标准	Min	/	24	190
Spec	Max	/	/	210
实测值		667	24	201

3、尺寸公差

名称	厚度	宽度	长度
标准	0.25±0.01	282±0.5	/
Min	0.24	281.5	/
Max	0.25	282.5	/

深圳市华宇创精密电子有限公司

电镀报告表

品名：USB AF 系列端子		版次：A.0
电镀规格：Au2ц″,Sn120ц″,Ni60ц″	日期：09-02-06	页次：1/1

厂商：恒鑫源五金电镀厂

测试设备：CMI X-射线膜厚测试仪

1、底层电镀测试（Ni）　（Ni）

数据（No）	Ni	测试日期	测试时间
1	62.5ц″	2009-2-6	09：12：13
2	64.6ц″	2009-2-6	09：12：13
3	60.5ц″	2009-2-6	09：12：13
4	64.8ц″	2009-2-6	09：12：13

2、表层电镀测试（Cu）　（Sn）

数据（No）	Ni	测试日期	测试时间
1	144.9ц″	2009-2-6	09：12：13
2	145.9ц″	2009-2-6	09：12：13
3	146.8ц″	2009-2-6	09：12：13
4	147.9ц″	2009-2-6	09：12：13

3、表层电镀测试（Au）

数据（No）	Ni	测试日期	测试时间
1	2.91ц″	2009-2-6	09：12：13
2	2.67ц″	2009-2-6	09：12：13
3	2.62ц″	2009-2-6	09：12：13
4	2.61ц″	2009-2-6	09：12：13

深圳市华宇创精密电子有限公司

盐雾测试记录表

试验日期	2009年2月6日	实验样品名称：AF 系列 外壳	
供应商名称	恒鑫源五金电镀厂	数量	10PCS
试验日期：06日20时6分至02日08时6分　　共计　12 时 1　分			
试验中若有中断其原因为：			

试验项目	测试标准值	实际测试值
盐水浓度	5%	5%
喷雾量	1.0-2.0ml/80cm/h	1.6ml/80cm/h
PH值	6.5-7.2	7.1
空气压力	1.00±0.01kgf/cm	1.0kgf/cm
试验室相对温度	85%	85%
试验室温度	35℃±1℃	35.8℃
压力桶温度	47℃±1℃	47.3℃
盐水温度	35℃±1℃	35℃

判定结果　　■合格　　□不合格

检验仪器：盐雾测试机

检验条件：照明度710克斯（LUX）以上，眼睛离被视物30公分检验时间为5秒。

判定：依标准图判定

审核：Choice　　检验员：祖文